

FBA42060

用于单相升压功率因数校正的 PFC SPM® 45 系列

特性

- 通过 UL 第 E209204 号认证 (UL1557)
- 600 V - 20 A 单相升压功率因数校正, 包含栅极驱动和保护的控制 IC
- 使用陶瓷基板实现非常低的热阻
- 全波桥式整流器和高性能输出二极管
- 针对 20 kHz 开关频率进行优化
- 内置负温度系数热敏电阻可实现温度监测
- 绝缘等级: 2000 Vrms/ 分钟

应用

- 单相升压功率因数校正转换器

相关资料

- [AN-9091 - Boost PFC Inductor Design Guide](#)
- [AN-9072 - Motion SPM® 45 Series Mounting Guidance](#)

概述

FBA42060 是一种先进的 PFC SPM® 45 模块, 为消费、医药和工业应用提供非常全面的高性能升压功率因数校正输入功率平台。这些模块综合优化了内置 IGBT 的栅极驱动以最小化电磁干扰和能量损耗。同时也提供多重模组保护特性, 集成欠压闭锁, 过流保护, 热量监测和故障报告。这些模块内的全波整流器和高性能输出二极管, 为额外节省空间和方便安装起到了重要作用。

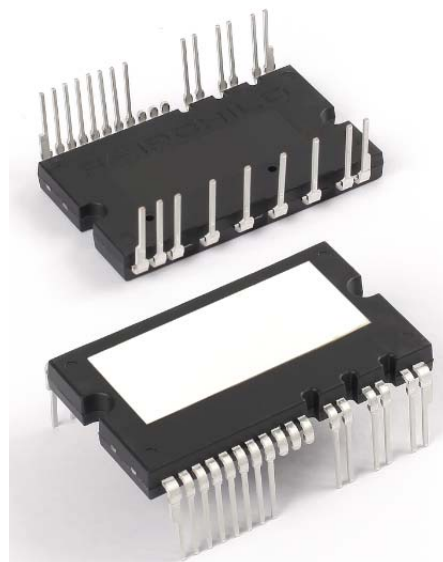


图 1. 封装概览

封装标识与订购信息

器件	器件标识	封装	包装类型	数量
FBA42060	FBA42060	SPMAA-F26	Rail	12

集成的驱动、保护和系统控制功能

- 对于 IGBT: 栅极驱动电路、过流保护 (OCP)、控制电源欠压锁定 (UVLO) 保护
- 故障信号: 对应 OC 和 UV 故障
- 内置负温度系数热敏电阻: 温度监控
- 输入接口: 高电平有效接口, 可用于 3.3/5V 逻辑电平, 施密特触发脉冲输入

引脚布局

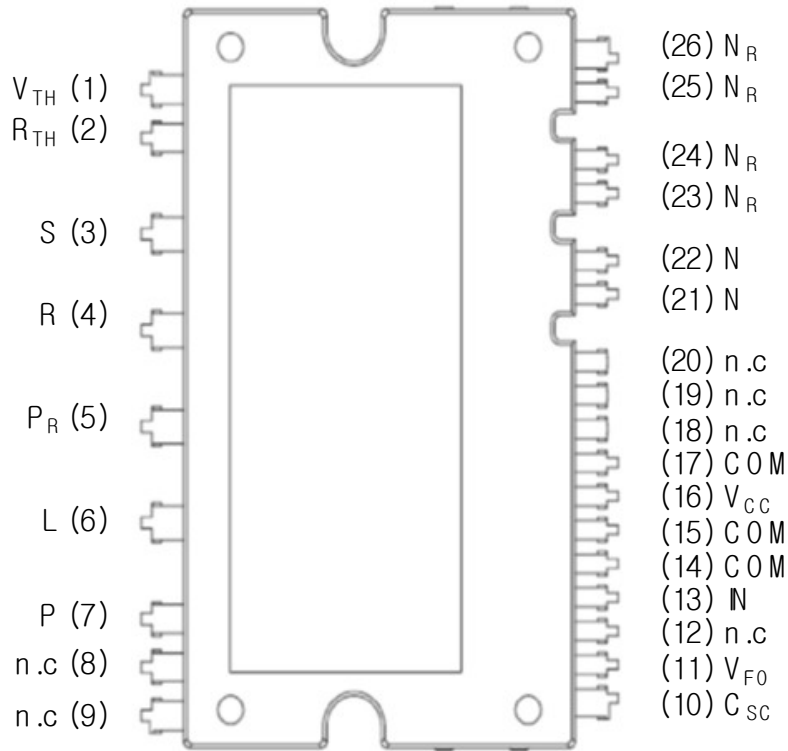


图 2. 俯视图

引脚描述

引脚号	引脚名	引脚描述
1	V _{TH}	热敏电阻偏压
2	R _{TH}	供热敏电阻使用的串联电阻器
3	S	S 相的交流输入
4	R	R 相的交流输入
5	P _R	整流器直流正端
6	L	电感连接
7	P	直流输入正端
8, 9	N.C	-
10	C _{OC}	过流检测的信号输入
11	V _{FO}	故障输出
12	N.C	-
13	IN	IGBT 驱动的 PWM 输入
14	COM	公共电源接地
15	COM	公共电源接地
16	V _{CC}	适用于 IGBT 驱动的 IC 的公共电源电压
17	COM	公共电源接地
18 ~ 20	N.C	-
21, 22	N	直流输入负端
23 ~ 26	N _R	整流二极管的直流负端

内部等效电路

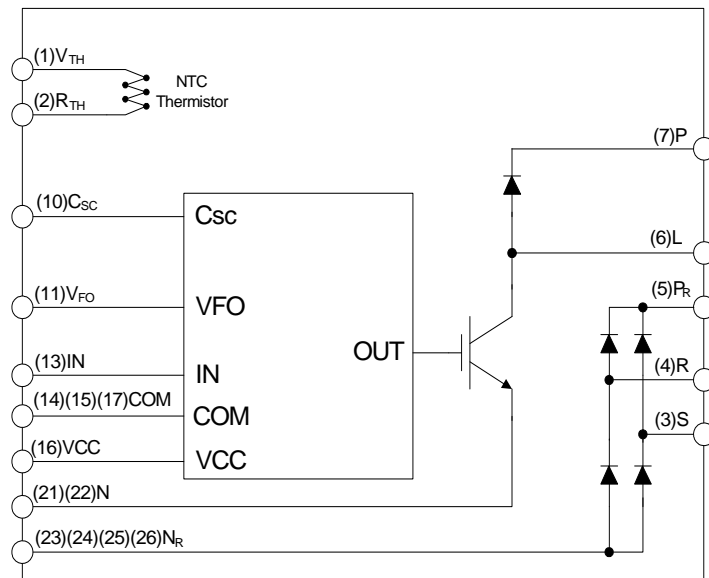


图 3. 内部框图

绝对最大额定值

转换器部分

符号	参数	工作条件	额定值	单位
V_i	输入电源电压	施加在 R - S 之间	276	V_{rms}
V_i (浪涌)	输入电源电压 (浪涌)	施加在 R - S 之间	500	V
V_{PN}	输出电压	施加在 $P_R - N_R$ 之间	450	V
V_{PN} (浪涌)	输出电源电压 (浪涌)	施加在 $P_R - N_R$ 之间	500	V
V_{CES}	集电极 - 发射极之间电压		600	V
V_{RRM}	重复峰值反向电压		600	V
$\pm I_C$	单个 IGBT 的集电极电流	$T_C = 25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 15\text{ V}$	20	A
$\pm I_{CP}$	单个 IGBT 的集电极电流 (峰值)	$T_C = 25^\circ\text{C}$, 脉冲宽度小于 1 ms	30	A
I_{FSM}	正向浪涌峰值电流	单一正弦半波	200	A
T_J	工作结温		-40 ~ 150	$^\circ\text{C}$

控制部分

符号	参数	工作条件	额定值	单位
V_{CC}	控制电源电压	施加在 $V_{CC} - \text{COM}$ 之间	20	V
V_{IN}	输入信号电压	施加在 IN - COM 之间	-0.3 ~ $V_{CC} + 0.3$	V
V_{FO}	故障输出电源电压	施加在 $V_{FO} - \text{COM}$ 之间	-0.3 ~ $V_{CC} + 0.3$	V
I_{FO}	故障输出电流	V_{FO} 引脚处的灌电流	1	mA
V_{SC}	电流感测输入电压	施加在 $C_{SC} - \text{COM}$ 之间	-0.3 ~ $V_{CC} + 0.3$	V

整个系统

符号	参数	工作条件	额定值	单位
T_{STG}	存储温度		-40 ~ 125	$^\circ\text{C}$
V_{ISO}	绝缘电压	60 Hz, 正弦波形, 交流 1 分钟, 连接陶瓷基板到引脚	2000	V_{rms}

热阻

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$R_{th(j-c)Q}$	结点 - 壳体的热阻在芯片中心	IGBT	-	-	2.5	$^\circ\text{C/W}$
$R_{th(j-c)D}$		FRD	-	-	2.5	$^\circ\text{C/W}$
$R_{th(j-c)R}$		整流器	-	-	2.5	$^\circ\text{C/W}$

电气特性 ($T_J = 25^\circ\text{C}$, 除非另有说明。)

转换器部分

符号	参数	工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{CE(SAT)}$	IGBT 集电极 - 发射极间饱和电压	$V_{CC} = 15\text{ V}$, $V_{IN} = 5\text{ V}$, $I_C = 20\text{ A}$	-	2.2	2.7	V
V_{FF}	快速恢复二极管正向电压	$I_F = 20\text{ A}$	-	2.1	2.6	V
V_{FR}	整流器正向电压	$I_F = 20\text{ A}$	-	1.1	1.4	V
t_{ON}	开关特性	$V_{PN} = 300\text{ V}$, $V_{CC} = 15\text{ V}$, $I_C = 20\text{ A}$, $V_{IN} = 0\text{ V} \leftrightarrow 5\text{ V}$, 电感负载 (注 1)	-	770	-	ns
t_{OFF}			-	640	-	ns
$t_{C(ON)}$			-	130	-	ns
$t_{C(OFF)}$			-	50	-	ns
t_{rr}			-	40	-	ns
I_{rr}			-	4.0	-	A
I_{CES}			集电极 - 发射极间漏电流	$V_{CE} = V_{CES}$	-	-

注:

1. t_{ON} 和 t_{OFF} 包括模块内部驱动 IC 的传输延迟时间。 $t_{C(ON)}$ 和 $t_{C(OFF)}$ 指在内部给定的栅极驱动条件下, IGBT 本身的开关时间。
详细信息, 请参见图 4。

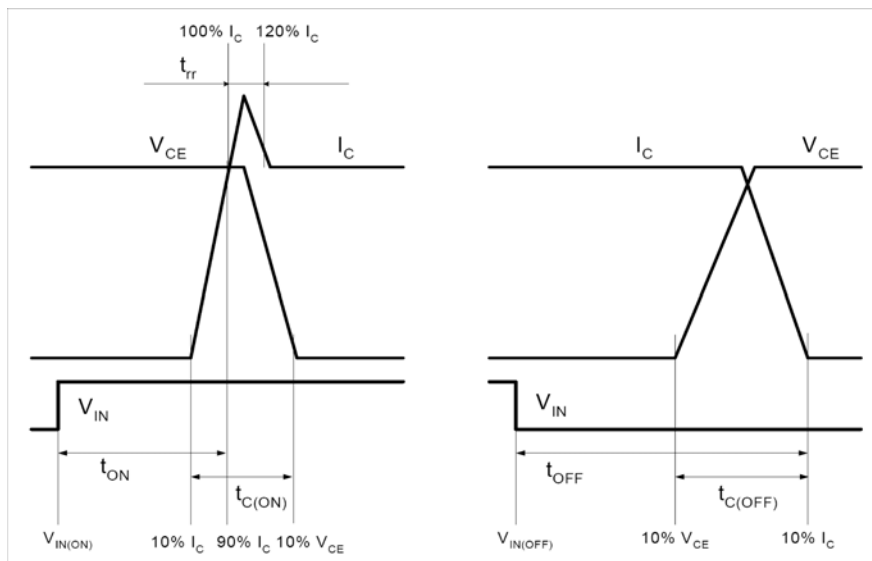


图 4. 开关时间定义

控制部分

符号	参数	工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
I_{OCC}	V_{CC} 静态电源电流	$V_{CC} = 15\text{ V}$, $V_{IN} = 0\text{ V}$, $V_{CC} - \text{COM}$	-	-	2.65	mA
V_{FOH}	故障输出电压	$V_{SC} = 0\text{ V}$, V_{FO} 电路: 4.7 k Ω 至 5 V 上拉	4.5	-	-	V
V_{FOL}		$V_{SC} = 1\text{ V}$, V_{FO} 电路: 4.7 k Ω 至 5 V 上拉	-	-	0.8	V
$V_{SC(\text{ref})}$	C_{SC} 引脚的过流保护触发电平电压	$V_{CC} = 15\text{ V}$ (注 2)	0.45	0.50	0.55	V
UV_{CCD}	电源电路 - 欠压保护	检测电平	10.5		13.0	V
UV_{CCR}		复位电平	11.0		13.5	V
$V_{IN(\text{ON})}$	导通阈值电压	施加在 IN - COM 之间	-	-	2.6	V
$V_{IN(\text{OFF})}$	关断阈值电压		0.8	-	-	V
R_{TH}	热敏电阻的阻值	$T_{TH} = 25^\circ\text{C}$ (注 3)	-	47.0	-	k Ω
		$T_{TH} = 100^\circ\text{C}$	-	2.9	-	k Ω

注:

- 过流保护作用于 IGBT。
- T_{TH} 为热敏电阻自身的温度。若需获得结壳温度 (T_C)，请根据具体应用进行试验。

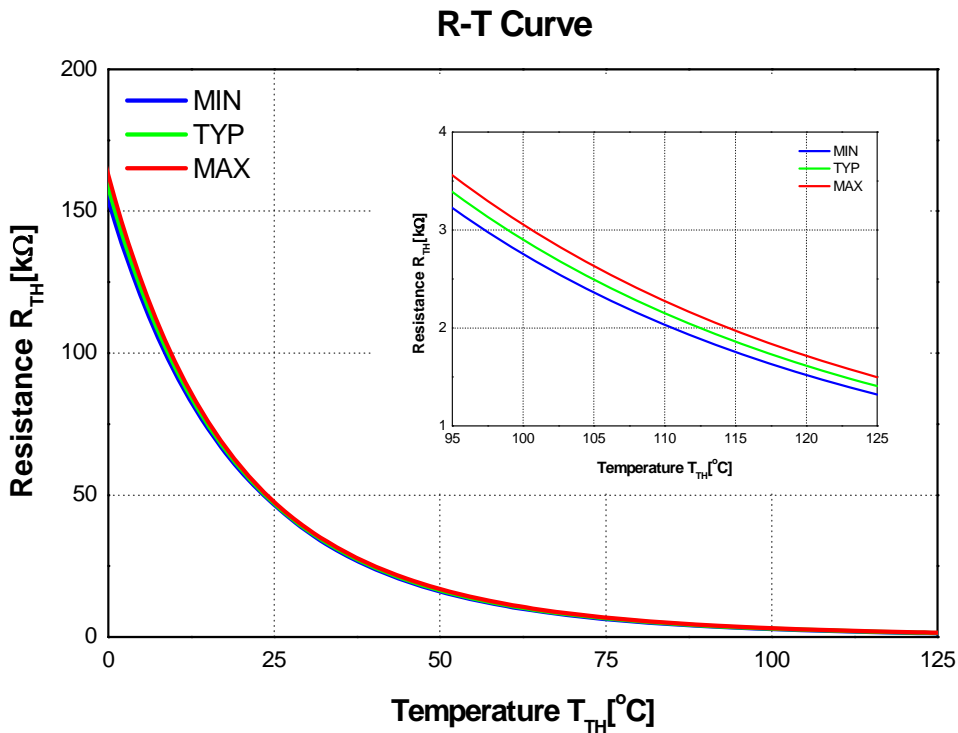


图 5. 内置热敏电阻的 R-T 曲线

推荐工作条件

符号	参数	工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_i	输入电源电压	施加在 R - S 之间	198	220	242	V_{rms}
V_{PN}	电源电压	施加在 P_R - N 之间	-	360	400	V
I_i	输入电流	$V_{DC} = 360\text{ V}$, $F_{SW} = 20\text{ kHz}$, $V_{CC} = 15\text{ V}$, $T_C = 90^\circ\text{C}$, $T_J \leq 150^\circ\text{C}$	-	20	-	A_{peak}
V_{CC}	逆变器的电源电压	施加在 V_{CC} - COM 之间	13.5	15.0	16.5	V
$P_{WIN(ON)}$	最小输入脉宽	(注 4)	0.5	-	-	μs
$P_{WIN(OFF)}$			0.5	-	-	μs
dV_{CC}/dt	电源波动		-1	-	1	$\text{V}/\mu\text{s}$
f_{PWM}	PWM 输入频率	$T_J \leq 150^\circ\text{C}$	-	20	-	kHz
V_{SEN}	电流感测产生的电压	施加在 N - COM 之间 (包括浪涌电压)	-4	-	4	V

注:

4. PFC SPM® 产品可能不会响应, 若输入脉宽低于最低推荐值。

机械特性和额定值

参数	工作条件		最小值	典型值	最大值	单位
安装扭矩	安装螺钉: M3	建议 0.7 N•m	0.6	0.7	0.8	N•m
器件平面度		见图 6	0	-	+120	μm
重量			-	11	-	g

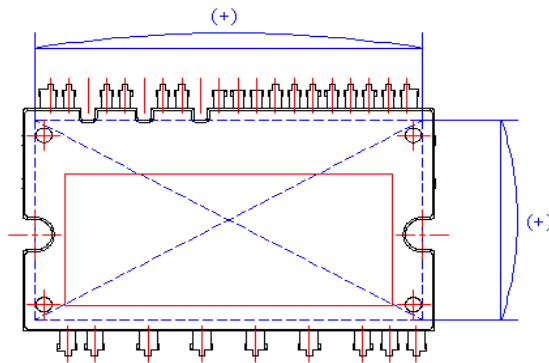
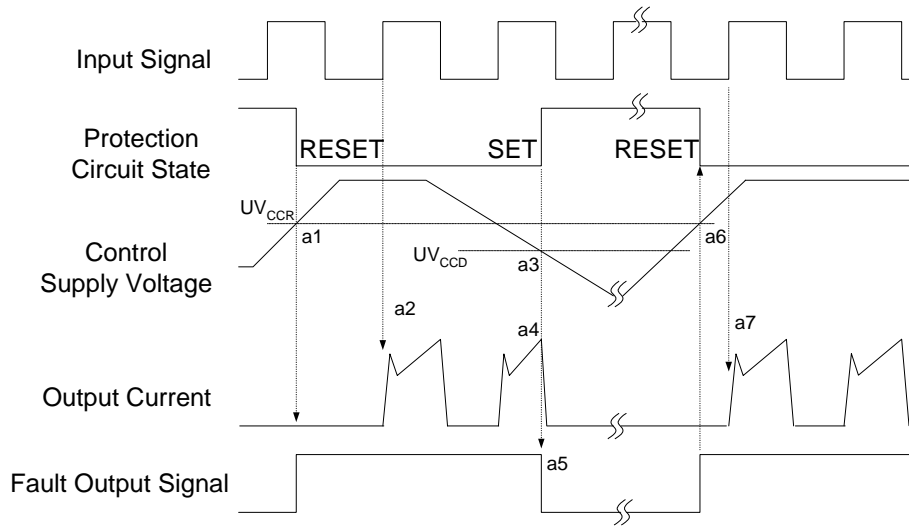


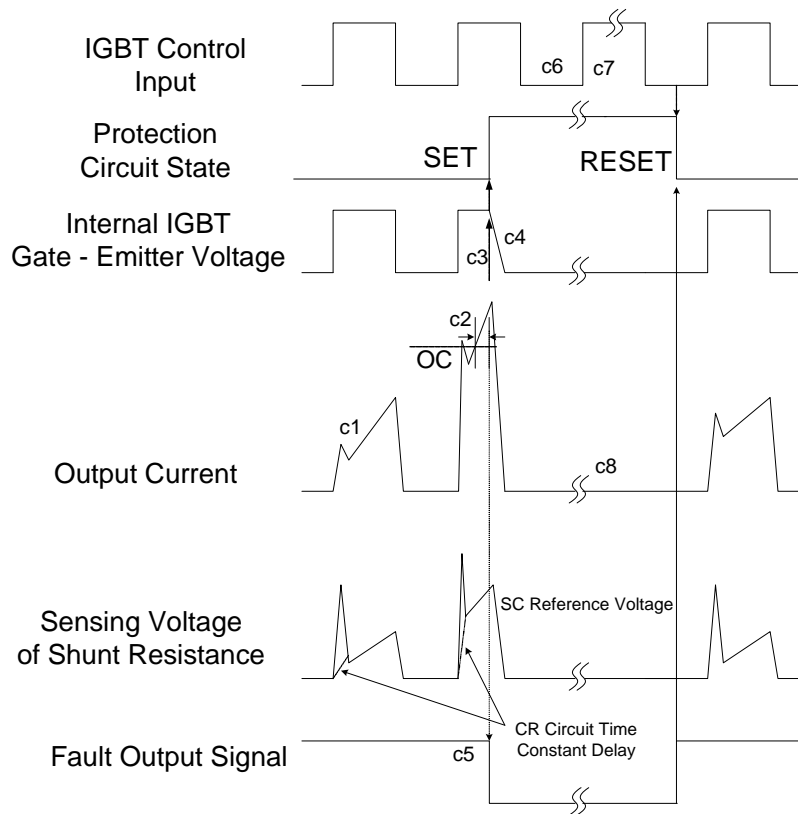
图 6. 平面度测量位置

保护功能时序图



- a1 : 控制电源电压上升: 当电压上升到 UV_{CCR} 后, 等到下一个开通信号时, 对应的电路才开始动作。
- a2 : 正常工作: IGBT 导通并加载负载电流。
- a3 : 欠压检测 (UV_{CCD})。
- a4 : 不论控制输入的条件, IGBT 都关断。
- a5 : 故障输出工作启动。
- a6 : 欠压复位 (UV_{CCR})。
- a7 : 正常工作: IGBT 导通并加载负载电流。

图 7. 欠压保护



(包含外部分流电阻和 CR 连接)

- c1 : 正常工作: IGBT 导通并加载负载电流。
- c2 : 过流检测 (OC 触发)
- c3 : IGBT 栅极硬中断。
- c4 : IGBT 关断。
- c5 : 故障输出计时器启动。
- c6 : 输入 "LOW": IGBT 关断状态。
- c7 : 输入 "HIGH": IGBT 导通状态, 但是在故障输出有效的时间内, IGBT 不导通。
- c8 : IGBT 关断状态

图 8. 过电流保护

应用电路推荐

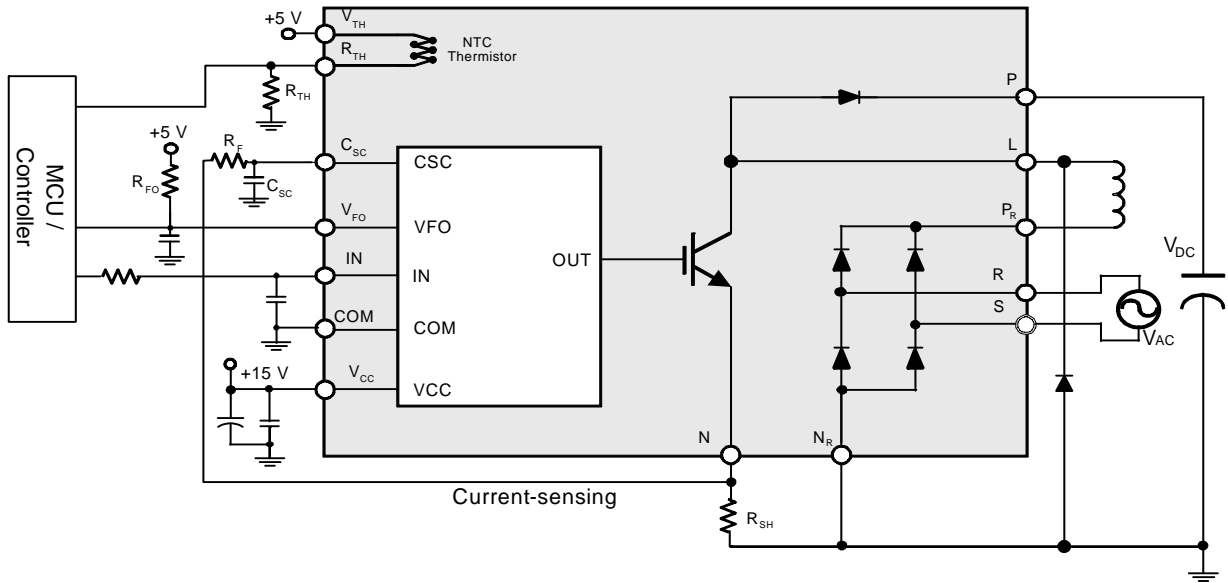
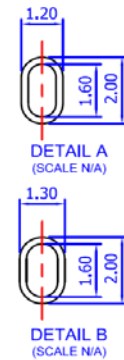
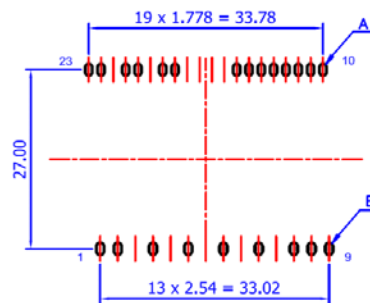
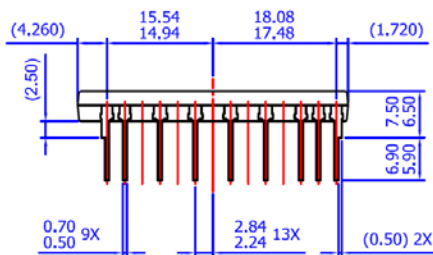
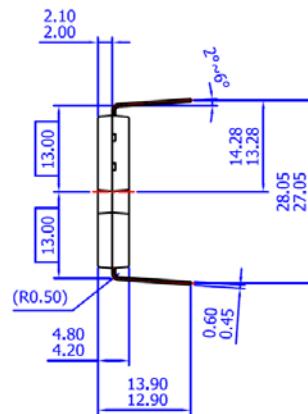
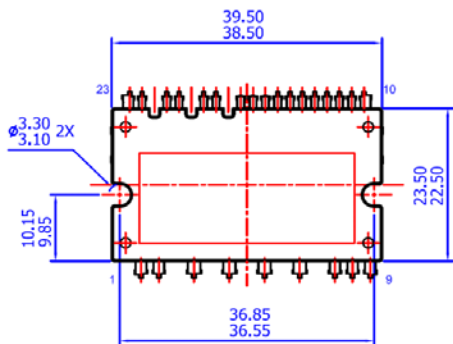
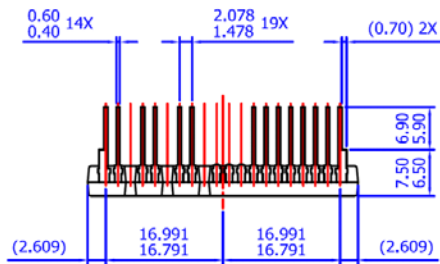


图 9. 典型应用电路

注:

1. 为了避免故障，应尽可能缩短每个输入端的连线（小于 2-3 cm）。
2. V_{FO} 输出是漏极开路型。该信号线应当采用一个能把 I_{FO} 上升到 1 mA 的电阻上拉至 MCU 或 PFC 控制器电源的正极。
3. 输入信号为高电平有效。在 IC 中，有一个 5 k Ω 的电阻将每一个输入信号线下拉接地。应采用 RC 耦合电路，以避免输入信号波动。 $R_S C_{PS}$ 时间常数应在 50 ~ 150 ns 的范围内进行选择（建议 $R_S = 100 \Omega$, $C_{PS} = 1 \text{ nF}$ ）。
4. 为避免保护功能出错，应尽可能缩短 R_F 和 C_{SC} 周围的连线。
5. 在过流保护电路中， R_F , C_{SC} 时间常数应在 1~2 μs 的范围内进行选择。
6. 每个电容都应尽可能地靠近引脚安装。
7. 在各种家用电器设备中，几乎都用到了继电器。在这些情况下，MCU 和继电器之间应留有足够的距离。
8. 内部负温度系数热敏电阻用来监控壳体温度，以及保护器件免于过热工作。请选择一个合适的电阻 R_{TH} 根据应用。例如，当壳体温度为 85 $^{\circ}\text{C}$ 时，使用 $R_{TH} = 4.7 \text{ k}\Omega$ 将使 R_{TH} 两端的电压变为 2.5 V。
9. 请使用一个合适的分流电阻 R_{SH} ，以保护内部 IGBT 免于过流工作。
10. 建议将反向并联二极管与 IGBT 相连接。

封装轮廓详图



LAND PATTERN RECOMMENDATIONS

- NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 A) THIS PACKAGE DOES NOT COMPLY TO ANY CURRENT PACKAGING STANDARD
 B) ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
 C) DIMENSIONS ARE EXCLUSIVE OF BURRS, MOLD FLASH, AND TIE BAR EXTRUSIONS
 D) () IS REFERENCE
 E) [] IS ASS'Y QUALITY
 F) DRAWING FILENAME: MOD23AAREV1.0

封装图纸作为一项服务，提供给考虑飞兆半导体元件的客户。具体参数可能会有变化，且不会做出相应通知。请注意图纸上的版本和 / 或日期，并联系飞兆半导体代表核实或获得最新版本。封装规格并不扩大飞兆公司全球范围内的条款与条件，尤其是其中涉及飞兆公司产品保修的部分。






随时访问飞兆半导体在线封装网页，可以获取最新的封装图纸：

<http://www.fairchildsemi.com/dwg/MO/MOD23AA.pdf>



TRADEMARKS

The following includes registered and unregistered trademarks and service marks, owned by Fairchild Semiconductor and/or its global subsidiaries, and is not intended to be an exhaustive list of all such trademarks.

AccuPower™	F-PFS™		Sync-Lock™
AX-CAP®*	FRFET®	PowerTrench®	 SYSTEM GENERAL®
BitSiC™	Global Power Resource™	PowerXS™	TinyBoost®
Build it Now™	GreenBridge™	Programmable Active Droop™	TinyBuck®
CorePLUS™	Green FPS™	QFET®	TinyCalc™
CorePOWER™	Green FPS™ e-Series™	QS™	TinyLogic®
CROSSVOLT™	Gmax™	Quiet Series™	TINYOPTO™
CTL™	GTO™	RapidConfigure™	TinyPower™
Current Transfer Logic™	IntelliMAX™	 Saving our world, 1mW/W/kW at a time™	TinyPWM™
DEUXPEED®	ISOPLANAR™	SignalWise™	TinyWire™
Dual Cool™	Making Small Speakers Sound Louder and Better™	SmartMax™	TranSiC™
EcoSPARK®	MegaBuck™	SMART START™	TriFault Detect™
EfficientMax™	MICROCOUPLER™	Solutions for Your Success™	TRUECURRENT®*
ESBC™	MicroFET™	SPM®	 SerDes®
 Fairchild®	MicroPak™	STEALTH™	UHC®
Fairchild Semiconductor®	MicroPak2™	SuperFET®	Ultra FRFET™
FACT Quiet Series™	MillerDrive™	SuperSOT™-3	UniFET™
FACT®	MotionMax™	SuperSOT™-6	VCX™
FAST®	mWSaver®	SuperSOT™-8	VisualMax™
FastvCore™	OptoHiT™	SupreMOS®	VoltagePlus™
FETBench™	OPTOLOGIC®	SyncFET™	XS™
FPS™	OPTOPLANAR®		

* Trademarks of System General Corporation, used under license by Fairchild Semiconductor.

DISCLAIMER

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT FURTHER NOTICE TO ANY PRODUCTS HEREIN TO IMPROVE RELIABILITY, FUNCTION, OR DESIGN. FAIRCHILD DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF THE APPLICATION OR USE OF ANY PRODUCT OR CIRCUIT DESCRIBED HEREIN; NEITHER DOES IT CONVEY ANY LICENSE UNDER ITS PATENT RIGHTS, NOR THE RIGHTS OF OTHERS. THESE SPECIFICATIONS DO NOT EXPAND THE TERMS OF FAIRCHILD'S WORLDWIDE TERMS AND CONDITIONS, SPECIFICALLY THE WARRANTY THEREIN, WHICH COVERS THESE PRODUCTS.

LIFE SUPPORT POLICY

FAIRCHILD'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORPORATION.

As used herein:

1. Life support devices or systems are devices or systems which, (a) are intended for surgical implant into the body or (b) support or sustain life, and (c) whose failure to perform when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in a significant injury of the user.
2. A critical component in any component of a life support, device, or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

ANTI-COUNTERFEITING POLICY

Fairchild Semiconductor Corporation's Anti-Counterfeiting Policy. Fairchild's Anti-Counterfeiting Policy is also stated on our external website, www.fairchildsemi.com, under Sales Support.

Counterfeiting of semiconductor parts is a growing problem in the industry. All manufacturers of semiconductor products are experiencing counterfeiting of their parts. Customers who inadvertently purchase counterfeit parts experience many problems such as loss of brand reputation, substandard performance, failed applications, and increased cost of production and manufacturing delays. Fairchild is taking strong measures to protect ourselves and our customers from the proliferation of counterfeit parts. Fairchild strongly encourages customers to purchase Fairchild parts either directly from Fairchild or from Authorized Fairchild Distributors who are listed by country on our web page cited above. Products customers buy either from Fairchild directly or from Authorized Fairchild Distributors are genuine parts, have full traceability, meet Fairchild's quality standards for handling and storage and provide access to Fairchild's full range of up-to-date technical and product information. Fairchild and our Authorized Distributors will stand behind all warranties and will appropriately address any warranty issues that may arise. Fairchild will not provide any warranty coverage or other assistance for parts bought from Unauthorized Sources. Fairchild is committed to combat this global problem and encourage our customers to do their part in stopping this practice by buying direct or from authorized distributors.

PRODUCT STATUS DEFINITIONS

Definition of Terms

Datasheet Identification	Product Status	Definition
Advance Information	Formative / In Design	Datasheet contains the design specifications for product development. Specifications may change in any manner without notice.
Preliminary	First Production	Datasheet contains preliminary data; supplementary data will be published at a later date. Fairchild Semiconductor reserves the right to make changes at any time without notice to improve design.
No Identification Needed	Full Production	Datasheet contains final specifications. Fairchild Semiconductor reserves the right to make changes at any time without notice to improve the design.
Obsolete	Not In Production	Datasheet contains specifications on a product that is discontinued by Fairchild Semiconductor. The datasheet is for reference information only.

Rev. 166